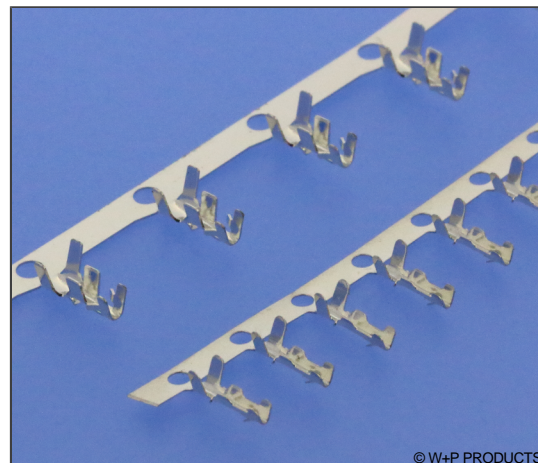
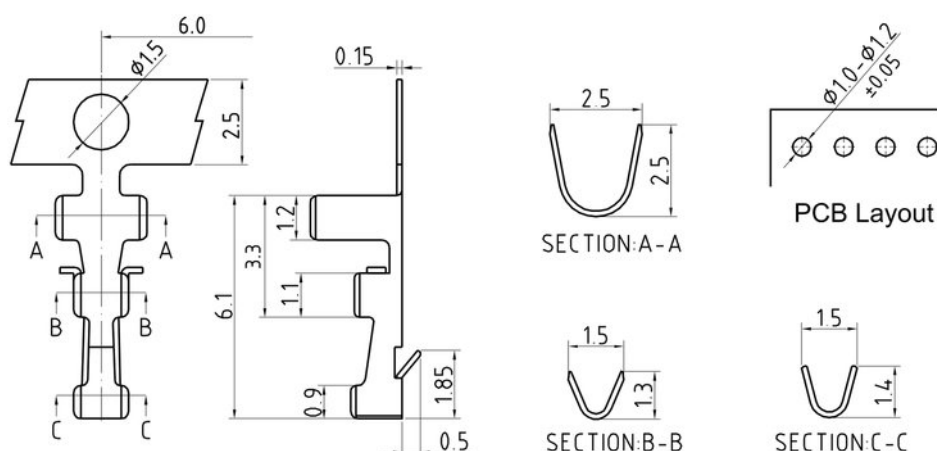


Technische Daten / Technical Data

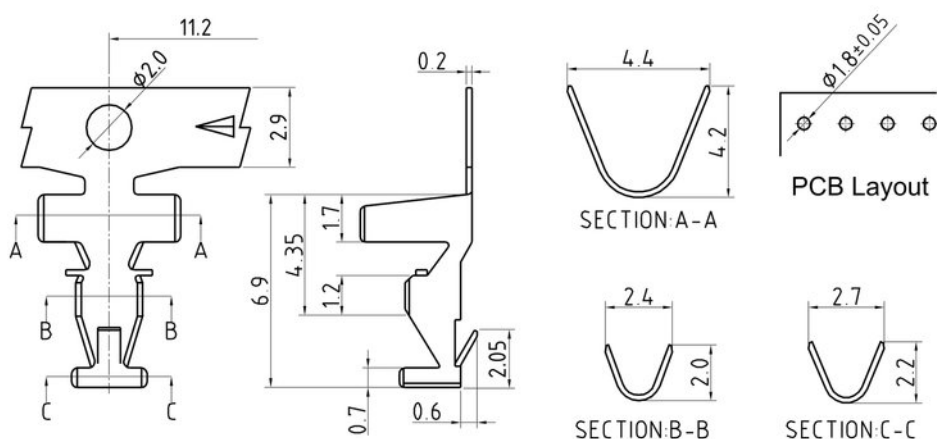
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Zinn über Nickel
Contact Surface	Tin plated over nickel
Aderquerschnitt	Lt. Optionen
Applicable wire Gauge	Acc. to Options
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Verarbeitung	Wellenlötverfahren
Processing	Wave soldering



© W+P PRODUCTS



Series	Contacts	Type	Plating	Diameter	Wire Gauge
600	01	2	50	10	2428
		2 Crimp-Kontakte Crimp terminals	50 Sn	10 1.0 ~ 1.2mm Bohrung 1.0 ~ 1.2mm diameter	2428 AWG 28 ~ 24



Series	Contacts	Type	Plating	Diameter	Wire Gauge
600	01	2	50	18	1822
		2 Crimp-Kontakte Crimp terminals	50 Sn	18 1.8mm Bohrung	1822 AWG 22 ~ 18

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:

